

第6回半導体デバイスプロセス技術基礎講座 2023

【半導体パッケージ技術の基礎とチップレット集積化に向けた取り組みの現状と課題】

主催：大阪公立大学 協創研究センター 半導体超加工・集積化技術研究所

https://www.omu.ac.jp/orp/org/crc/semicon_tech/

協賛：エレクトロニクス実装学会、応用物理学会関西支部、応用物理学会シリコンテクノロジー分科会、
化学工学会エレクトロニクス部会、化学工学会反応工学部会CVD反応分科会、CVD 研究会

後援：近畿経済産業局

日時：2024年3月6日（水）16:00～18:50

開催場所：大阪公立大学 I-site なんば 2階 C2&C3 / A1&A2（名刺交換会・技術交流会）

<https://www.omu.ac.jp/isite/access/>

講師：NEP Tech. S&S ニシダエレクトロニクス実装技術支援 西田 秀行 氏

講演概要：先端の半導体デバイスは構造や材料・プロセスを劇的に変化させながら進展を続けてきたが、ムーアの法則の鈍化と共に、新しい概念の導入により革新的進化を続けている。埋め込み電源配線（Buried Power Rail, BPR）や裏面電源供給ネットワーク（Backside Power Delivery Network, BSPDN）など従来はパッケージが有した機能をウエーハプロセス（配線工程）に組み込み、配線工程とパッケージ技術の境界がなくなりつつある。また、「1チップに複数の機能を持たせる」から「特定の機能を持つチップをパッケージ内に複数組み込んで高機能化する」、いわゆるチップレット化が加速している。本講演では、パッケージ技術の変遷・材料・構造や将来動向を概説する。また、3D/2.5D/2.3D/2.1D/Bridge 構造など、各社の高機能実装技術の特徴やチップレット化に伴う必須技術など、広範な最新技術と今後の動向を紹介する。

プログラム（若干時間が前後することがあります）

- 16:00～16:10 開催の挨拶
- 16:10～18:45 セミナー（途中休憩と質疑応答を含む）
- 18:45～18:50 閉会
- 19:00～20:00 名刺交換会・技術交流会



申し込み用 QRコード

- * 定員 100名(先着申込順)
- * 参加費「無料」
- * 申し込みは、右の QR コードもしくは下記の URL からお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGFRr6hE8AsRqjZM3eTXQqQ6qDAP1RaxCxJDfE-nCpNmGxjw/viewform?vc=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

- * 申し込み締め切り：2024年3月1日（金）
- * 問合せ先：大阪公立大学 協創研究センター 半導体超加工・集積化技術研究所
TEL.: 072-254-9821 e-mail: semicon.tech.omu@gmail.com

* 謝辞 本講座運営の一部は公益財団法人 東京応化科学技術振興財団から補助されています

